



제 29회 한국반도체학술대회

The 29th Korean Conference on Semiconductors

2022년 1월 24일(월) ~ 26일(수) | 강원도 하이원 그랜드호텔(컨벤션타워)

2022년 1월 26일(수), 15:45-17:30

Room E (루비 II, 5층)

A. Interconnect & Package 분과

[WE4-A] Emerging Interconnect

좌장: 이태익 박사(KITECH), 김병준 교수(한국산업기술대학교)

<p>WE4-A-1 15:45-16:15</p>	<p>Low-Carbon Interconnection Technology for Heterogenous Integration Kwang-Seong Choi, Jiho Joo, Yong-Sung Eom, Gwang-Mun Choi, Chanmi Lee, Ki-Seok Jang, In-Seok Kye, Ho-Gyeong Yun, and Seok Hwan Moon <i>ETRI</i></p>
<p>WE4-A-2 16:15-16:45</p>	<p>Thermal Management at Nanoscale for Electronics Hyejin Jang <i>¹Materials Science and Engineering, Seoul National University</i></p>
<p>WE4-A-3 16:45-17:00</p>	<p>Bonding and Interfacial Analysis of Polymer Substrates by CNT Microwave Heating 손민정^{1,2}, 김민수¹, 고용호¹, 주병권², 이태익¹ <i>¹한국생산기술연구원 접합적층연구부분 마이크로조이닝센터, ²고려대학교 전기 전자공학부 디스플레이 및 나노시스템 연구실</i></p>
<p>WE4-A-4 17:00-17:15</p>	<p>고전력 전기자동차 파워 모듈용 DBC 기판과 IMS 기판의 방열 특성 비교 정봉민^{1,2}, 이가원¹, 오애선², 배현철^{2,3} <i>¹충남대학교 전자공학과, ²한국전자통신연구원 DMC융합연구단, ³과학기술연합대학원대학교 ETRI스쿨 차세대소자공학과</i></p>
<p>WE4-A-5 17:15-17:30</p>	<p>스프링 구조 변화에 따른 고주파 영향 분석 김인섭, 김문정 <i>공주대학교 전기전자제어공학부</i></p>